**Nazwa przedmiotu:**

Technologia Urządzeń Mechatroniki II

**Koordynator przedmiotu:**

Dr inż. Ryszard Jezior, docent

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Mechatronika

**Grupa przedmiotów:**

Obowiązkowe

**Kod przedmiotu:**

TUM II

**Semestr nominalny:**

5 / rok ak. 2012/2013

**Liczba punktów ECTS:**

3

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

Wykład 15, laboratorium 15, ćwiczenia projektowe 15, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10, opracowanie sprawozdań 5, przygotowanie do ćwiczeń projektowych 10, przygotowanie sprawozdania z projektu 10, przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie 10.
Razem 90 godz. = 3 ECTS

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

Wykład 15, ćwiczenia w laboratorium 15, ćwiczenia projektowe 15.
Razem 45 godz. = 1,5 ECTS

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

Obecność w laboratorium 15, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10, opracowanie sprawozdań 5, ćwiczenia projektowe 15, przygotowanie do ćwiczeń projektowych 10, opracowanie sprawozdania z projektu 10.
Razem 65 godz. = 2,5 ECTS

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład: | 15h |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Znajomość materiałoznawstwa oraz podstaw technik wytwarzania.

**Limit liczby studentów:**

30

**Cel przedmiotu:**

Poznanie podstaw projektowania obwodów drukowanych, technologii obwodów drukowanych oraz technologii i montażu modułów elektronicznych.

**Treści kształcenia:**

W. : Technologia modułów elektronicznych. Definicja i rodzaje modułów. Rodzaje i własności laminatów. Technologia płyt obwodów drukowanych. Rodzaje obwodów drukowanych (jednostronne, dwustronne i wielowarstwowe) i ich wytwarzanie. Metody wykonywania otworów w obwodach drukowanych: wiercenie, obróbka laserowa, trawienie. Montaż obwodów drukowanych: przewlekany THT, powierzchniowy SMT, mieszany. Technologia COB. Metody łączenia stosowane w obwodach drukowanych: lutowanie ręczne, lutowanie automatyczne, zgrzewanie oporowe, laserowe, ultradźwiękowe, połączenia stykowe, połączenia owijane, połączenia zaciskane. Metody klejenia i kleje stosowane w montażu obwodów drukowanych. Zabezpieczenia powierzchni obwodów drukowanych. Zagadnienia termiczne w obwodach drukowanych i ich wpływ na technologię.
L. : Frezowanie uzębień drobnomodułowych, Wiercenie otworów o małych średnicach, Technologia elementów z proszków metali, Zgrzewanie oporowe, Rolerowanie czopów ułożyskowań zegarowych, Drążenie ultradźwiękowe, Wykonywanie i badanie połączeń klejonych
P. : Na podstawie rysunku obwodu elektrycznego zaprojektować za pomocą wybranego programu komputerowego rysunek konstrukcyjny płytki obwodu drukowanego.

**Metody oceny:**

Egzamin po V semestrze

**Egzamin:**

tak

**Literatura:**

1. Kisiel R.: Podstawy technologii dla elektroników, Wyd. BTC, Warszawa 2005
2. Szczepański Z., Okoniewski B.: Materiałoznawstwo i technologia dla elektroników, WSiP Warszawa 2007
3. Michalski J.: Technologia i montaż płytek drukowanych. WNT, Warszawa, 1992
4. Oleksy H. i inni: Montaż elementów elektronicznych na płytkach drukowanych. WKiŁ, Warszawa, 1984
5. Mika M.: Obwody drukowane. WKiŁ, Warszawa, 1979
6. Praca zbiorowa: Technologia sprzętu elektronicznego – Laboratorium. Skrypt PW, 1984

**Witryna www przedmiotu:**

**Uwagi:**

## Efekty przedmiotowe

### Profil praktyczny - wiedza

**Efekt Wpisz opis:**

Wpisz opis

Weryfikacja:

Wpisz opis

**Powiązane efekty kierunkowe:**

**Powiązane efekty obszarowe:**

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Efekt TUM II\_W01:**

Posiada uporządkowaną wiedzę na temat rodzajów i metod wytwarzania obwodów drukowanych, wykonywania otworów w obwodach drukowanych, wykonywania pokryć ochronnych obwodów drukowanych oraz metod montażu elementów i podzespołów elektronicznych na płytach obwodów drukowanych.

Weryfikacja:

Egzamin

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_W16, K\_W17

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_W03, T1A\_W04, T1A\_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Efekt TUM II\_U01:**

Potrafi zaprojektować obwód drukowany z wykorzystaniem dostępnych programów komputerowych np. PROTEL, EAGLE itp..Potrafi dobrać rodzaj obwodu drukowanego, materiał płytki obwodu drukowanego, metodę wykonania otworów w obwodzie drukowanym, rodzaj i metodę wykonania pokryucia ochronnego obwodu drukowanego oraz metodę montażu elementów i podzespołów elektronicznych.

Weryfikacja:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_U03, K\_U05, K\_U07, K\_U08, K\_U20, K\_U27

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_U04, T1A\_U05, T1A\_U09, T1A\_U16, T1A\_U16, T1A\_U11

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

**Efekt TUM II\_K01:**

Potrafi pracować w zespole podczas planowania i wykonywania określonych zadań inżynierskich.

Weryfikacja:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_K01, K\_K03, K\_K04, K\_K05

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_K01, T1A\_K02, T1A\_K07, T1A\_K03, T1A\_K04, T1A\_K05, T1A\_K06